

SH-putty3

熱伝導パテ

LiPOLYのSH-putty3 シリーズは、熱伝導率：8.0 W/m*K の隙間充填材です。変形性が高く、隙間に合わせて上手く充填し、公差を補う特性も備えております。また、パティの逆流、乾かす等の問題もなく、熱がより良く伝導することができます。当社が開発のディスペンサーを使って、自動化生産ラインには適切な製品です。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率: 8.0 W/m*K
/ 推奨塗布厚み 100~3000μm
/ 公差を補われる特性
/ 精密部品には圧力をかからず
/ 垂れせず
/ バッチ生産可能
/ 高圧縮及び低応力環境には適合

■ 製品アプリケーション

/ CPUと放熱シンの隙間
/ PCコンポーネントと放熱シンの隙間
/ 高速記憶装置
/ 通信設備
/ フラットパネルディスプレイ
/ セットトップボックス
/ ネットワークカメラ
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 容量の単位

/ カートリッジ: 30ml, 55ml, 330ml
/ ペール缶: 1kg, 25kg

■ 保存期間

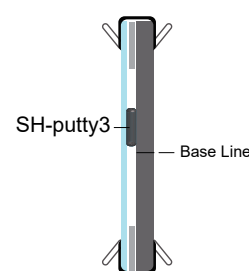
/ 当製品が未使用の状態
室温30度の条件には60ヶ月
が保存できます。

■ 代表特性

物理特性	SH-putty3	試験方法	単位
色	Gray	Visual	-
主成分	Silicone	-	-
粘度	17000	DIN 53018	Pa.s
流量 (30cc EFDチューブ、 内径2.35mm、90psi&60s)	32	By LiPOLY	g/min
密度	3.4	ASTM D792	g/cm³
使用温度	-60~180	-	°C
推奨塗布厚み	100~3000	-	μm
保存期間	60 months	-	-
ROHS & REACH	Compliant	-	-
電気特性			
絶縁破壊電圧	12	ASTM D149	KV/mm
体積抵抗率	>10 ¹³	ASTM D257	Ohm-m
熱特性			
熱伝導率	8.0	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10psi / 60°C	0.039	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@30psi / 60°C	0.035	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@50psi / 60°C	0.031	ASTM D5470	°C-in²/ W

■ 垂れ落ち試験

3.0mmのシートを使って、隙間調整を行う。パティをアルミ板とガラス板の間に乗せて、試験前にはパティの位置を表記し、125°Cのオーブンに1000時間ベーキングした後を取り出して、パティの位置を再確認する。



高温試験終了後、材料は元の位置からずれるかを確認する